# 产品流程 与注意事项



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2020, Opulinks. All Rights Reserved.

## **REVISION HISTORY**

Date	Version	Contents Updated
2020-12-01	1.0	Initial Release



## **TABLE OF CONTENTS**

## **TABLE OF CONTENTS**

1.	介绍	2
	1.1. 文档应用范围	2
	1.2. 参考文献	2
2.	OVERVIEW	3
3.	第 1 阶段:立项评估	4
4.	第 2 阶段-PCBA 设计制作	5
5.	第 3 阶段-PCBA 调试	7
6.	第 4 阶段-试产	8



## **LIST OF FIGURES**

## **LIST OF FIGURES**

FIGURE 1: 产品完整流程	3
Figure 2: 第 1 阶段流程图	1
FIGURE 3: 第 2 阶段流程图	5
Figure 4: 第 3 阶段流程图	7
Figure 5: 第 4 阶段流程图	8



#### 1. 介绍

#### 1.1. 文档应用范围

本文档介绍产品完整流程,由原厂提供过往经验及芯片的特性,让客户能在最高效率下顺利量产,内容包括:事前须知、每一阶段需准备项目、检查确认、关键提醒、建议用料...等,请务必仔细阅读并遵行。

#### 1.2. 参考文献

(1) Github/HDK 参考设计下载

https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000-HDK/tree/master/Module



#### 2. OVERVIEW

下方流程图为从一开始提出提供数据给客户, 到产品硬件设计完成

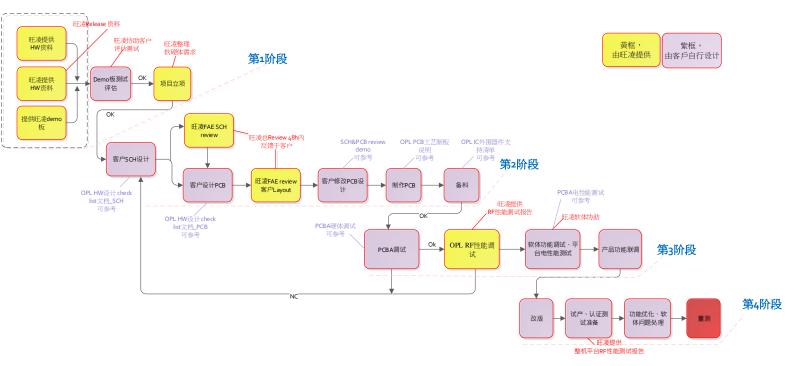


Figure 1: 产品完整流程



## 3. 第1阶段:立项评估

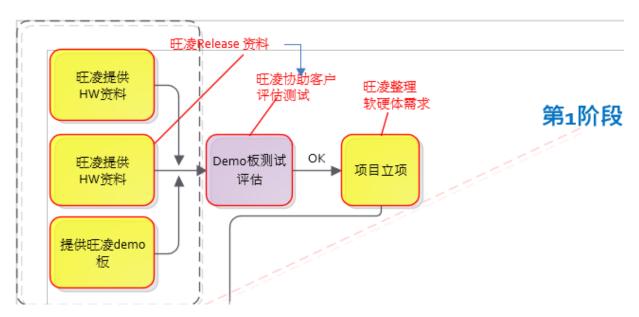


Figure 2: 第 1 阶段流程图

第1阶段,清楚客户需求,并共同订定出 milestone。

#### ▶ 客戶提供

- 1. 客户软硬件需求
- 2. demo 板测试评估

#### ▶ 旺凌提供

1. HDK 参考设计可上 github<sup>1</sup>下载

#### [注意事项]

✓ 烦请客户产品功能需求清晰明了·协助 FAE 完成文件" SZ FAE project information Demo"·以 利后续人力与资源安排与时程规划。



## 4. 第 2 阶段-PCBA 设计制作

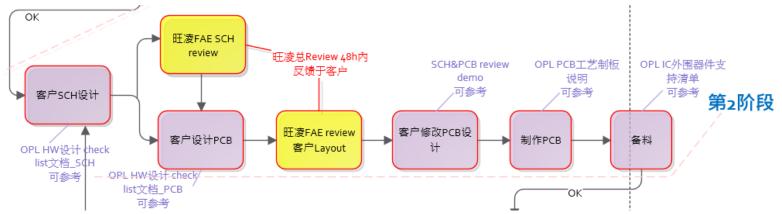


Figure 3: 第 2 阶段流程图

第2阶段,完成硬件设计,SCH/layout 再次 review,并协助物料选用。

#### > 客戶提供

1. SCH/layout 设计

#### ▶ 旺凌提供

- 1. 文檔" OPL HW 设计 check list", 可參考
- 2. 文檔" SCH&PCB review demo",可參考
- 3. 文檔 "OPL PCB 工艺制板说明", PCB 制作可参考
- 4. 文檔" OPL 外围器件支持清单",可參考

#### [注意事项]

✓ 由于芯片体积较小,且支持双模(WIFI+ 蓝芽),为避免 RF 性能受影响,必须使用四层版

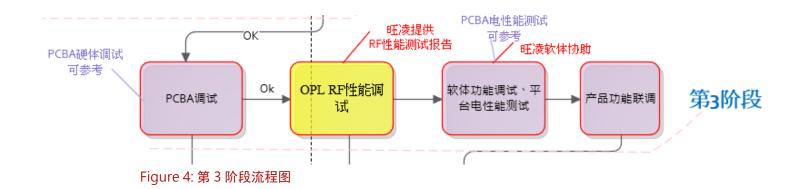


## **CHAPTER FOUR**

- ✓ 請客戶完成 SCH/layout 設計后,務必發給旺凌 FAE 做確認后再发板(PCB),旺凌 FAE 协助再次確認檢查,將錯誤機會降至最低,旺凌 FAE 確認完畢後,會提供文檔" SCH&PCB review",讓客戶再次確認。
- ✓ 备料时·OPL 芯片外·关键电子物料(晶振、Flash、电感、LDO等)·务必采用公版物料推荐列表 (APL)·避免影响芯片的敏感性。
- ✓ 再次提醒,由于 RF 性能需多方面考虑,需专业仪器与数据分析,因此初期开发验证,不建议客户 自行做模块,否则将造成开发时程延误与资源浪费。



### 5. 第 3 阶段-PCBA 调试



第 3 阶段,旺凌会协助调整 RF 性能、电性性能,以及软件功能整合测试,请客户配合完成该做的性能测试。

#### > 客戶提供

1. 至少 3-5 块 PCBA 给旺凌调试、测试 RF 性能、产品电性能

#### ▶ 旺凌提供

- 1. 文件"PCBA 硬件调试", PCAB 调试可参考
- 2. 文件"PCBA 电性能测试",可参考
- 3. 测试报告" RF 性能测试报告"

#### [注意事项]

- ✓ 在小批量前,请让旺凌协助一同完成模块性能评估,包含完成 "PCBA 电性能测试"。
- ✓ OPL 芯片由于低功耗缘故,模块设计须谨慎与遵守旺凌建议,因此做完电性能测试后,请将模块设计定版(e.g. Layout, BOM),任何硬件設計与物料變動 · 请务必主动通知旺凌 FAE 询问并确认,以保证模快性能质量。



## 6. 第 4 阶段-试产



Figure 5: 第 4 阶段流程图

第 4 阶段,为量产做前期准备,功能优化、改版、产测对接、或协助认证测试。

#### ▶ 客戶提供

1. 2-3 pcs 产品,做 RF RVR 测试

#### ▶ 旺凌提供

1. 整機平台 RF 性能测试报告 " OPL RF RVR test report"

#### [注意事项]

- ✓ 若客户模块或最终产品须认证测试(e.g. FCC, CE, SRRC),请提前告知旺凌,将给予认证建议评估。
- ✓ 旺凌已提供优化的标准产测流程与工具,若有额外产测需求与流程,请提前告知旺凌。



## **CONTACT**

sales@Opulinks.com

